JA 0096756 JUN 1983

(54) MOUNTING METHOD OF MULTICHIP PACKAGE:

(11) 58-96756 (A)

(43) <u>8.6.1983</u> (19) JP

(21) Appl. No. 56-194428

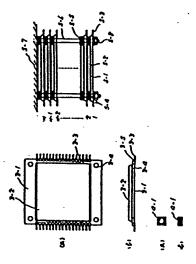
(22) 4.12.1981

(71) TOKYO SHIBAURA DENKI K.K. (72) YOSHITAKA FUKUOKA

(51) Int. Cl². H01L23/32,H01L23/02

PURPOSE: To perform mounting of the multichip packages having favorable efficiency by a method wherein penetrating holes of resin blocks are positioned to penetrating holes of two or more provided at the circumferential part of the respective multichip packages, and metal bars are inserted therein to be supported and to be fixed to a case body.

CONSTITUTION: FIC's are supported to be fixed to a substrate 3-1, and are sealed airtightly by a cap 3-2. Input-output terminals 3-3 are soldered with silver solder 3-5 outwardly and in parallel with the face of the substrate. The penetrating holes 3-4 are provided in the substrate 3-1 at the circumference of the cap 3-2.
Penetrating holes 4-1 of the same diameter with the hole 3-4 of the substrate 3-1 are provided in the resin blocks of Teflon, etc., having a little elasticity, and utilizing the holes 4-1 of the blocks 5-5 thereof and the holes 3-4 of the substrate, the rigid body bars 5-6 of metal, etc., are inserted using the blocks 5-5 as the interlayer insulators, and the tips are fixed by screws to the case body 5-7. By this constitution, the multichip packages of a large number can be mounted having favorable efficiency and in high density to the case body having a space in the perpendicular direction.



11m2158-36756 (2

49 日本国特許庁 (JP) || ||本子でまいた。 | 日本の日本日本の日本

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A) 昭58—96756

in a Olnce Cl. H.01 L 23/32 23/02

ឿស៊ីខណៈសង់១០ j .

識別記号 庁内整理番号 6240-5F 7738-5F

母公開 昭和58年(1983)6月8日

発明の数 1 密查請求 未請求

(全 5頁)

⊗マルチチップパッケージの実装方法

1 20特 頭 昭56—194428

「三〇出^{作・注}類 ⁴昭56(1981)12月 4 日

第50発 明 4者・福岡教孝

រៃស់៖ គគារនេក 🗔

1 6

大変 いうさいくし 1.4.7 14.7 Miles

8年17年(通常在工作)

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

①出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

①代 理 人 弁理士 則近憲佑 5 外1名

O. マルナナップパッケージの実会方法

は特許請求の範囲:

∤さんさき 河明の人

(1) 配額 茶板上に夜数個の電子的機能要果をナッ **水型で突接 じっぱ当は配破場板の周辺部に電子的** 鹿長末であるナップな品店収近に子行に配線を O.外向 もに入出力加子を形成し、全体を気密封 でくれてデブギの基体を搭載したマルナナッ カゲージの実施方法に於て、前記第1の記載 の気患対応すべく形成されたギャップ等の考 1. 外側の周辺部の少なくとも 2 ヶ所以上に選扎 101、 第 2 ~ 第 N の配款基板の周辺話にも第 1 **重を板と同一箇所に同一サイズの通孔を改け、** 事の通孔と如る大きな大きさを有じ、それの 祝とほぼ何ーナイズの内孔を具備してたる高 演記マルカナラブペッケージの気密封正用の 大字の を休の前記記録 基板表面からの高さ ||【多少高めの多少界力性を有するプロックを 1. はブロジクを各々の配線を板間及び配線

毎板と産体券の店外との間に挿入し、浦1から郡 Nまでの配礎若板の十ぺての通孔と、各々の配線 岩板間及び配線岩板と嵌体等の岩体との間に挿入 した冬々のブロックの十ぺての近孔とを記立する 模な少なくとも2本以上の所体権を、前記すべて の通孔に挿入し、その開体線の先端部を遊休等の 店体に固度せしめるボにより、何1から低Nまで のマルナチップパッケーツを支持固定せ心める事 ・を特徴とするマルチチップパッケージの契袋方法。 (2) 蔵作寺の基体に支持規定されたポーーのHも ての冬々のマルナナップパッケージの配線芸長の 似于的 級能 製煮 であるチップ 臨品 客 成 歯 と 半行 に 配盤帯板の外向を化形成された前記名々の入出力 据子の存在している位氏と同一位反配膜を有する 入出力は子の大きさより多少大きめの近孔を有し、 作定の回路 機能を有すべく配膜を形成したフレキ シブル配線塩板を形成し、成プレキシブル配破岩 仮をは I ~茲Nのマルチナップパッケージの各々 の入出力増子に挿入し、接対する水により、ポー ~斯Nミでのマルチナップパッケージ相互間の耳

排局等58-96756(2)

微的最级企形成十名事を特徵と十名前配特許請求 の観点祭し項尼根のマルチナップパッケ 4 方法 00700 - 850日 4 方法 00700 - 850日

国前記多小外力性を有するプロックがブロック 形状ではなく、前記記録者板のキャップギの毛体 同一位世にほぼ同一の大きさの流孔を設け、前記 気密封正すべきキャップ等の希体の周辺を母び様 在環状構造を有する事と特徴とする前に特許請求 の観光部1項記載のマルナナップパッケージの実 袋 方 佉 。 特拉萨特点

3. 希明の詳細な説明。 発明の属する技術分野。

本発明は、配磁省版上に使数数の電子的機能費 果をナップ状態で実長し、全体を気密封止すべく ヤヤップ再の岩体を塔扱したマルチチップパッケ ークの実長方法に関するものである。

* 従来技術とその問題点

近年,属于极高の小型、延星化、高速化、高值 顔性化の根求が若しく高まって来ており、それ等

例えばヘンダ付けたるいはクエルディング帯によ り支持固定されたセナップ寺の海休1-2、及び 民職者収1~1の周辺部に例えばハンチ付けある いは銀虫=付け谷により形成された入山力雄子! 汀ふから構成されている。娘にひいてしーも仕場 子的機能せまであるIC-チップを、1-5は何 じくコンデスサーチップを示してやり、また1-6.は、それ等の1.Cナップ1~5 と配線を板1~ との電気的袋貌を形成する例えば Au 磁等のワイ ヤーも示している。この役なマルナチップペッケ わけてある場合との様を場合、従来市2四(同は 平面図、個は側面図)に示す如く所謂るブリント 起鉄道板 2 元4上にお1回に示すマルチチェブス 2.名三クの入出力増予1-3を折り曲げ成形し、 七の人出力進元2.一3を前記プリント配職等収2 (主) ものスペーポール内に挿入し、例えばヘンダ付 比2元 5.毎で支持固定する単化よりマルチテップ マスケークを複数値ブリント配磁右板上に実験し、 各性のマルナナスブバッケージの反気的療徒を形

の根水を側足すべく例えばアルミナセラミック省 パッケーツのNB 板上に再体ペースト及び絶縁はペーストを印刷を の場体1ー2のA 乗、錦成を挟り返し、役職する年により特定の国] 十名键左胡合化科 ・略級能を持たせる所は厚膜配程施板底、あるいは 発明の火政門 グリーンシート上に非体ペーストと絶談体ペース 以下、水质明点 トを乾燥状態で繰り返し根板した後、及元界性気。収明する。 引る皮 刃で同時能成する事に依り特定の回路機能を持た 発明によるマル。 せる所謂る印刷技権メメライズドセラミック基紙 ちのであり、3~ 去、あるいはグリーンシートに金母パンナング节 チップやのチップ により遠孔を形成し、その上に導体ペーストを印 3 ~ 2 はそれらの 期、乾燥し、それ時のグリーンシートを複数枚重く配線水板3-1 ね合わせ加圧した後、及元界暗気炉で同時焼成すデイング存の手法 る事に依り特定の国格機能を存んせる所謂るソー権体を示す。また ト種層広等により形成した森密度配線基板上にしてジッチップ活品 Cナップ等のナップ部品を複数個実施し、全体を付けあるいは彼の 気密到止する所謂るマルチチャブパッケージン 3成された入出力点 4 仕本発明による: 技術が開発されつつある~

この妹なマルナチップパッケージの外板構造!プダの名体3~; しては、新1回で示す如く高密度配顧若板1~形成された少さくと 及び全体を気密封止しすべく配線電板1-1上パケ所)の近孔をデ

成する事によりしつのシステムを形成していた。とんチナップパック ととに於て、2-1はマルナナップパッケージ「棺となった。5-配母基底、2-2は気密封止用のヤヤップ等の)配線を収、5-2 体をそれぞれ示している。しかしながらとの例^{ヤップ}平の場体、 方法では、形成すべきしつのシステムを組み込^{りの}入出力端子を **液体等の基体の平面的左面状が前記マルチチョ^の開体権の先援を** パッケージ(おし図)を従政城塔根できる祖才したそのポルトを た面積を有する場合は問題はないが、前記直開^{から}飛りまでの_{す。} の場体の平面的な面板がマルチナップパッケー塩子 5 一3 の 電気に (据13月)の平面的左面状とほぼ同等左面级 K 全転 7 イヤー等! 存在しない場合には、その嵌体等の着体内に 個のマルナナップパッケージを実践する事は「任可挽成配線易仮! なはだ凶難であり成十十ぺる無かった。

発明の目的

本希明はこの後を事情を考慮して成された。所定の各入出力点 であり、その目的とする所は、平面的な面はやり、当該可夠放配 さな液体等の垢水化効率点く改多くのマルナト配線垢板)をマル プパッケージを英模する方法を提供するGKM子5~3 に挿入し 尚、本名明社府尼亚体布の基体の平面的北部 特超定し,这点的 有十る平面と症候な方向には、終紀マルナイトつ信頼性良くの4

モ) にあらかじめき O入出力端子 5 ~ 3

(6)

į.

福町58-96756(2)5

计過程 € BI M € 化より特定の図

1 基級 佐にあるいは ストと物味はベース した後、避元芬坦気 定の回路機能を持た メドセクミックモ坂 に食品ではある。 :ド本体ベーストを印 -ンジートを禁放状業 李维然更七同語的成十 を存んせる所属るグー 高密度配職基板上K I

344425-35756CCCE

注流:

がナナー人の配譲る板I-1の月さとキャップ等 eft. in aggreen の名は1-2の高さの和の政策のスペースが存在 大る様を場合に特に有効である。

発明の実施資料を対象

出以下、本処男の一実施例を図面を非照しながら 级明十名。新工阀(以平面网、以间面两)杖、本 発明によるマルナナップパッケージの構造を示す ものであり、3 - 1 はモ子的機能要素である I C ナップ等のナップ部品は支持固定する配破高板。 3-2はそれらのチップ服品全体を気密対止すべ (配験場板35-11-上化ハンダ付けあるいはクエル デイング帝の手法により形式されたキャップ等のい 着体を示す。また3三3位、マルナナップパッケ こりのチップ 脳島塔蔵面に千行に外向きにハンメ 複数個英雄し、全体を付けるるいは低ロー3-5付け寺の手佐により形 ップパッケージングはされた入出力増子を示するのである。また3-くは本発明による気密對止すべく形成されたキャ ミッケーツの外膜構造と、ブ等の著体3ー2の周辺層の配線指板3ー1に : 高密度配線を収1ード成された少なくとも2ヶ所以上(図においては こく記載者板1-1上間が所)の点孔を示している。前4切(は)は平面図、

ステムを形成していた。ルナチップバッケージを効率及く突張するなが ナナップパッカニリ 起となった。5-1はマルナナップパッケーツ ・、止用のキャップ等の記載者質、5~2は気密封止すべく形成された 1. しかじながらこのはプァブ等の事体、S-3はマルナチップパッケ いつのシステムを組み込むの入出力増子を示す。また5-8は前記金属 大面根が放配式やする。 0月休報の先頭を例えばポルトガによりネッ止 ENTREMENT & SET STATE OF SET O 14周昭58-96756(3)

(1) は何面図)は、本発明による配線を収3~1を 傷つける事のない様を多少が力性を有する例えば ナフロン等の歯腹ブロックを示してかり、 その例 えばテフロンギの歯磨ブロックには、前紀配線者 板3-1の周辺想に形成された造孔3-4とほぼ 同一サイメの通孔(一1が形成されている。 幕 5 奴は本苑男によるマルチナップパッケージ(ボる 対)を液体等の複体 5 ~ 7 に実装した実装方法を 示す何面図である。 すなわられ 1 のマルチチップ パッケージから終Nのマルチナップパッケージの 各々の間及びボNのマルナチップパッケージと正 体との間に、前記マルチチップパッケージの周辺 邸に設けた少々くとも2ヶ所以上の通孔3-4の 存在する位成に前記例えばテフロン等の関格プロ ァクS-5の通孔4~1の位置を合わせ当故ナフ ロン帝の街斯ブロック5-5(寒(娘)を挿入し、 これ等の通孔、仪数毎の3-4及び4-1を完通 十る様々例えば金属等の所体作 5 一6を挿入し、 その先端をネジ止め等の方法にて産体等の基体 5 - 7 K支持固定するずKより第しから新Nまでの

の入出力端子 5 - 3 間の電気的破硬が形成され得 るであろう。

発明の効果

本発明を採用する事により、平面的には小さな 近仗しか有さないが、それに施蔵を方向にはある 侵戌のスペースを有十る逆休券の着休に多数のマ ルナナップパッケージを効率よく作者に高密度に 異義する単が可能と成った。

· 発明の変形例

尚、本格明の一英雄例の図面だよる説明で、点 4 図の例えばテフロン等の樹脂プロックは、 4 6 頃(以子近闪、)) 質近處)に示十四く。前記マル ナチョブパッケージの気密封止すべく形成された キャップ等の老体の展題を選む様を堪状構造でし ても上い。但し近孔6~1は、マルナナップペッ ケーツの配蔵場板の周辺部に設けた通孔と同一位 氏にほぼ何ーサイメで形成する事が必要である。 また、本先男のマルナチョブパッケージの記録 岩 仮及び気管対止すべきキヤップ等の著作は、十ペ ・て長方形にて成明して来たが、とれは円形あるい

祖母\$8-96756(4)

・ ぎ 1-3,2-3,3-3,5-3… マルチナ 入出力增子、

2-4…ブリント配収基板、

3-4,5-4…本先明により形成されたマルチナップパ

ァケージ用配線着板筒辺の通孔。

5-6…本発明による企成帯の開体権。

5-7…証体等の場体。

近 度 佑 (ほか1名)

16,

a

3

4

(a)

Pos

一個女子海班市自然会出来企品。 "我是精神体生"。 1 ... 建沸腾体 1 万十 神出出口。 · 你把工具的原因的形式具工工作。 1. 李安 原 明 明 本 四 明 中 本 4

はない。 はない、では選子機器の超小型化に貢献する事を 可能成らしなる事ができた。

製造の実験方法を示す関、据3関(A)(B)技术発明による

1000円では、100円の大変が成立に対し、100円では、

「順注「1/2』」L,3-1:45-L…アルミナセラミック等のマ

まっていてでで、まっていちっていてルナナップパッケークの

京なさまナップパッケージを反射するための頃、A

1000年の簡単攻役明子・・

に示すさるロン寺の勇敢プロ

気管発止用のボオッズ寺の海体

}68686868686 &&&&&&&&&&&& 8888888888886 ું હેં.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.